



IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

全球徵案正式啟動



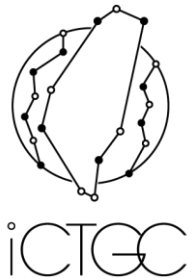
Organizer:  **國家科學及技術委員會**
National Science and Technology Council

Co-Organizers:  **semi**
國際半導體產業協會

 **TSIA** 台灣半導體產業協會
Taiwan Semiconductor Industry Association

 **TCA** 台北市電腦公會
TAIPEI COMPUTER ASSOCIATION

 **TTA** TAIWAN
TCH ARENA



晶創臺灣方案

Taiwan Chip-based Industrial
Innovation Program, Taiwan Cbi

利用矽島實力吸引國際新創與投資來臺

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

結合生成式AI+晶片帶動全產業創新

強化國內培育環境吸納全球研發人才

加速異質整合及先進技術



IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

推動目的

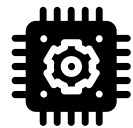
強化台灣全球最大IC新創聚落品牌
打造台灣成為夢想現實之地



吸引全球尖端科技人才
及創投資金來台



讓人才實質落地
帶動商機並驅動相關產業發展



整合在地IC設計、製造、
封裝測試到產品流程

競賽領域

運用AI晶片、AI演算法、高速傳輸等開發以下類別的先進應用解決方案，或就核心技術進行突破創新

分組1

AI Core
Technologies
and Chips

AI晶片設計
AI系統
硬體加速技術

分組2

Smart
Mobility

電動車
自動駕駛
通訊產業

分組3

Smart
Manufacturing

智慧製造
IC製程
機器人

分組4

Smart
Medtech

生物辨識
智慧監測
智慧醫療

分組5

Sustain
ability

永續製造
節能創新
新能源

競賽資格

- 規劃攜手台灣半導體晶片設計、製造產業，共同合作發展創新應用之新創、法人及學研機構、自然人
- 構想書內容包括：
技術核心、目前已解決或獲得驗證情形、
欲發展之商業模式、市場拓展規劃，並提交3分鐘以內的Pitch Video



40%

在地連結性

1. 具有來台資源需求及具體發展規劃
2. 為台灣產業提供更寬廣的發展空間

40%

價值創造性

1. 能帶動科技創新潛力，創造社會福祉
2. 促成新產業鏈結或促進產業升級之貢獻
3. 引進衍生投資或創造高度經濟價值之成效

20%

技術創新性

1. 於新興應用領域之創新性
2. 在製程、設計、新材料運用範疇具開創性
3. 能融入多元創新與整合跨域思維優勢



獲獎獎勵

1

獎金



美金 \$30,000

2

專家輔導



由半導體專家顧問
陪跑輔導

3

平台鏈結



鏈結從試製到生產資源
(EDA Tools, Wafer, etc.)

4

其他資源



其他多方資源及服務
確保順利落地

- 需實體來台鏈結，如參與TIE展 / COMPUTEX & InnoVEX

- 視融資規模（最高 300 萬美元）換取股權
- 獲選團隊需於宣布後3個月內投資協議

徵案顧問團與評審陣容

Industry



Bor-Sung Liang
Senior Director, MediaTek



Brandon Wang
VP, Synopsys



Henry Lee
Former Technical Director,
Sunplus



Jason Jeng
Technical Director,
UMC



Jerome Hung
Vice President, M31



Konrad Young
Former Chief of RD
Department, TSMC



Kris Peng
President,
UMC Capital



Kevin Wei
Sr. Business Development,
Synopsys



Ken Li
Formal President, Rafael
Microelectronics



Louis Lin
Senior Vice President,
GUC



Michel Chu
President,
ITIC



S. Z. Chang
Vice President & CTO,
PSMC



Todd Lin
COO,
EgisTec



Tsun-Jen Hou
Former RD Director,
Faraday



Tsung-Ching Wu
Co-founder and Executive of
Vice President, Atmel Corp



Weining Shen
Partner,
MediaTek Capital

加速器



公協會



研發機構



學界



IC新創加速平台

提供加速半導體方案(試製到生產)關鍵資源

EDA/IP/IC 設計

EDA & IP

Analog and digital processes

IC 設計服務

系統整合

SI Development Factory

模組整合
利基產品市場開發



晶圓製造

晶片製造

晶圓共乘服務

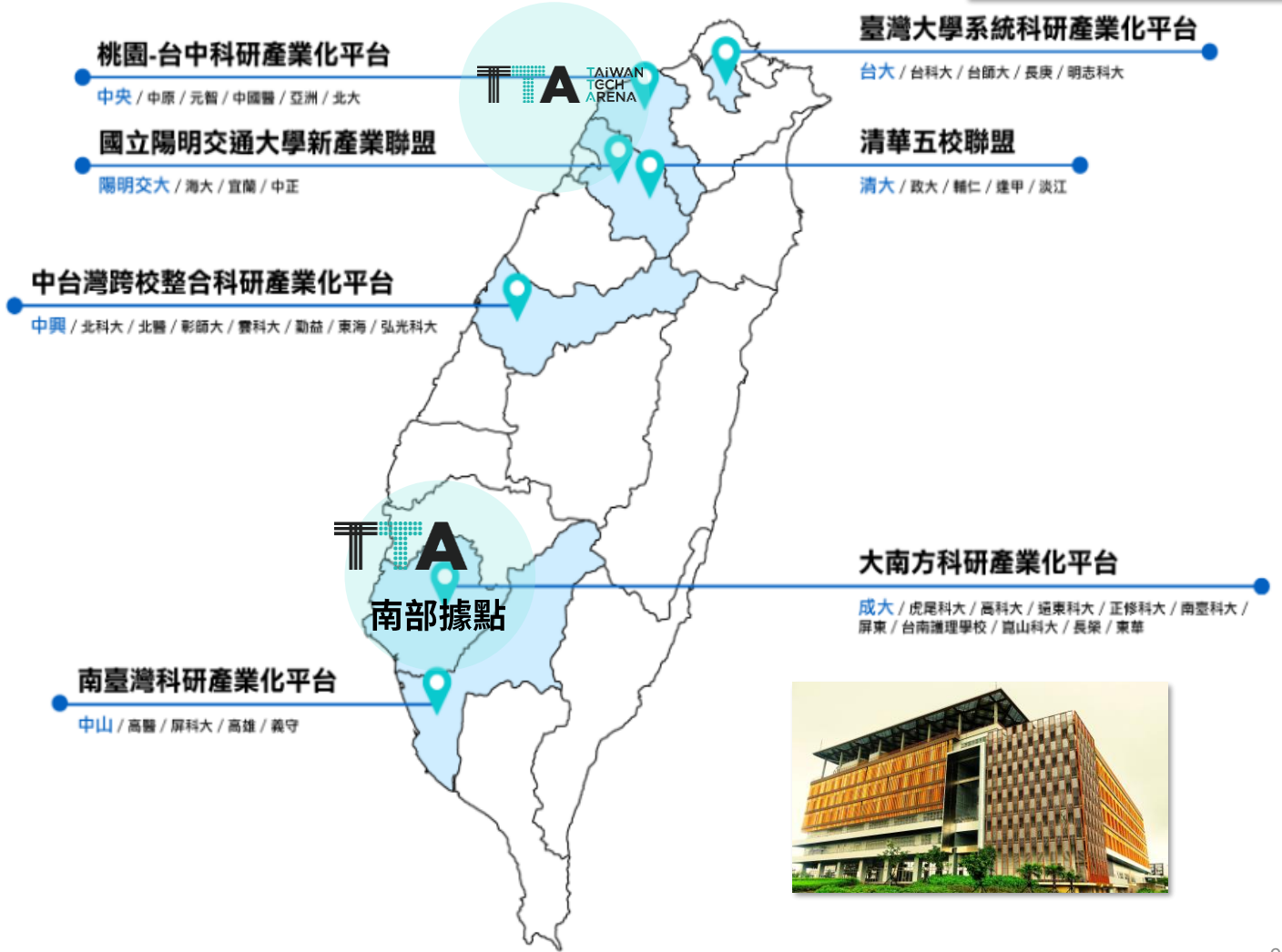
封裝及測試供應鏈

先進製程封裝測試

- 關鍵資源的資金（最高300萬美元）將透過SAFE（未來股權簡單協議）協議進行股權交換，並將由主辦單位直接支付給台灣供應商
- 如果新創公司所在國家的法規不適用SAFE，則會考慮其他股權交換方法

完善生態系資源

通往台灣國際級創業生態系統的大門



競賽時程

tie Taiwan Innotech Expo
台灣創新技術博覽會

Mar. 26th, 2025

Online Apply **Open**

***Winning teams will participate in the TIE expo held on Oct 16-18 in Taiwan**

COMPETITION TIMELINE

Jun. 30th, 2025

Online Apply **Deadline**





IC TAIWAN GRAND CHALLENGE



競賽官網

ictaiwanchallenge.org



Contact Us

台北市電腦公會 劉小姐
ariel_liu@mail.tca.org.tw
+886 2 25774249 Ext. 825

台北市電腦公會 陳先生
Jacky_chen@nstc.gov.tw
+886 2 25774249 Ext. 940

